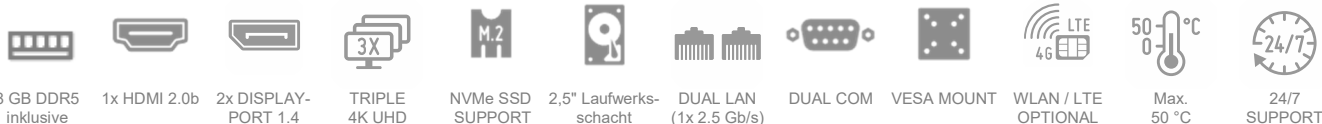
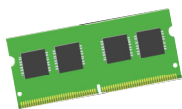


BAREBONE XPC slim DH610V2_Bundle_8GB



SLIM DESIGN

■ Flaches 1,35-Liter Metallgehäuse, schwarz ■ Abmessungen: 19 x 16,5 x 4,3 cm (LBH) ■ Mit VESA-Halterung (75/100 mm) ■ Unterstützt 24/7 Dauerbetrieb ■ Betriebstemperatur: 0-50 °C (nicht kondensierend)

BETRIEBSSYSTEM

■ Ein Betriebssystem ist nicht enthalten
■ Unterstützt Windows 10, Windows 11 und Linux (64-Bit)

PROZESSOR SUPPORT

■ Sockel LGA1700 unterstützt Intel Core Prozessoren der 12./13./14. Generation "Alder Lake-S" und "Raptor Lake-S [Refresh]": Core i9/i7/i5/i3, Pentium Gold und Celeron, max. 65W TDP
■ Heatpipe-Kühlsystem mit zwei Lüftern

GRAFIK

■ Integrierte Intel HD-Grafik, unterstützt 4K (Eigenschaften hängen vom Prozessortyp ab) ■ Unterstützt drei unabhängige UHD-Displays

CHIPSATZ

■ Intel H610 Chipsatz

RAM SPEICHER

■ 8 GB DDR5 RAM SO-DIMM-Modul mitgeliefert

ZEITLICH BEGRENZTES AKTIONSPRODUKT:

1,3-LITER BAREBONE-PC DH610V2 MIT 8GB RAM IM BUNDLE *)

Das Shuttle XPC slim Barebone DH610V2 mit H610 Chipsatz bringt die Performance von Intels 12., 13. und 14. Generation der Core Desktop-Prozessoren (Codename "Alder Lake-S" und "Raptor Lake-S [Refresh]") mit Sockel LGA1700 ins kompakte 1,3-Liter Format. Es unterstützt den gleichzeitigen Betrieb von drei Ultra HD Displays über 1x HDMI und 2x DisplayPort. Dual-Intel-Netzwerk (ein Port mit 2.5G-Geschwindigkeit), acht USB- und zwei COM-Ports sind ebenfalls vorhanden. Sein flaches Metallgehäuse mit VESA-Halterung, die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und der zuverlässige Betrieb bei bis zu 50 °C Umgebungstemperatur machen das DH610V2 ideal für professionelle Anwendungsbereiche wie zum Beispiel Digital Signage, POS, POI, Spielautomaten, Büro, Gesundheitswesen und Industrie.

*) dieses Bundle-Produkt ist zeitlich begrenzt verfügbar und nur solange Vorrat reicht

LAUFWERKE- SATA / M.2

■ 1x 2,5"-Schacht für SATA-Festplatte oder SSD
■ 1x M.2-2280M Steckplatz (unterstützt PCIe 3.0 x4 NVMe oder SATA)
■ 1x M.2-2230E Steckplatz für optionales WLAN-Modul

ANSCHLÜSSE

■ 1x HDMI 2.0b ■ 2x DisplayPort 1.4 ■ optional: VGA
■ 2x Audio (Mikrofon + Line-out) ■ 4x USB 3.2 Gen1 (1x Typ-C)
■ 4x USB 2.0 ■ 1x USB 2.0 intern ■ 2x RJ45 LAN-Ports (Intel 1G + 2.5G)
■ 2x COM-Port (1x RS232/422/485) ■ Anschluss für externen Power-Button ■ "Always-On" Jumper

POWER SUPPLY

■ Externes 120W/19V Netzteil ■ DC-Eingang unterstützt auch 12V

OPTIONALES ZUBEHÖR

■ WLAN Modul (WLN-M1 (Wi-Fi 6)/WLN-M12 (Wi-Fi 6E)) ■ Standfuß (PS02)
■ VGA-Anschluss (PVG01) ■ Rackmount-Kit (PRM01)
■ Kabel für externen Power Button (CXP01) ■ LTE-Kit (WWN03)
■ Hutschienen-Montage-Kit (DIR01)



Aktions-Produkte mit 8GB RAM inklusive

Produktname	Volumen	Prozessor oder CPU-Sockel	Kühlsystem	DDR5-Speichermodule	EAN Strichcode
DS50U_Bundle_8GB	1,3-Liter	Intel Celeron 7305 (Intel Core Gen 12)	Heatpipe ohne Lüfter	8 GB RAM enthalten	4046047104543
DS50U5_Bundle_8GB	1,3-Liter	Intel Core i5-1335U (Intel Core Gen 13)	Heatpipe ohne Lüfter	8 GB RAM enthalten	4046047104550
DH610V2_Bundle_8GB	1,3-Liter	Sockel-1700 für Intel Core Gen 12-14	Heatpipe mit Lüfter	8 GB RAM enthalten	4046047104567
DH810_Bundle_8GB	1,3-Liter	Sockel-1851 für Intel Core Ultra 2xx	Heatpipe mit Lüfter	8 GB RAM enthalten	4046047104574
XH810_Bundle_8GB	3,5-Liter	Sockel-1851 für Intel Core Ultra 2xx	Heatpipe mit Lüfter	8 GB RAM enthalten	4046047104581

LEISTUNGSMERKMALE



Robust, stilvoll und sehr klein
Man muss es selbst in der Hand gehalten haben, um zu merken, wie klein es wirklich ist. Das Stahlblechgehäuse verleiht diesem Slim-PC die nötige Stabilität für professionelle Anwendungen wie z.B. Digital Signage. Obwohl das Gehäuse für die gebotene Systemleistung mit nur 1,35 Litern sehr klein ist, wirkt der Aufbau nicht gedrängt, so dass die Installation leicht von der Hand geht. Dank seiner schlichten, stilvollen Optik wird es auch mancher stolzer Besitzer in seinem Büro oder zu Hause einsetzen.



Dual Netzwerk (Intel 1G + 2.5G)

Das DH610V2 bietet zwei Netzwerkanschlüsse mit Intel Netzwerk-Adaptoren - diese sind bekannt für exzellente Performance und Treiber-Kompatibilität und werden in manchen professionellen Bereichen bevorzugt eingesetzt. Ein LAN-Port unterstützt sogar bis zu 2,5 Gbit/s über herkömmliche Cat5e- oder bessere Verkabelung. Mit dem DH610V2 können Sie die Bandbreite Ihres Netzwerks erweitern und digitale Engpässe reduzieren.

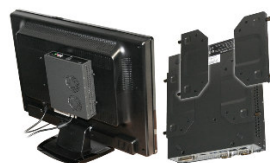
VESA-Halter

Mit der mitgelieferten 75/100mm-VESA-Halterung kann das DH610V2 an einer Wand, an einer Armhalterung oder hinter einem Monitor montiert werden, was speziell in Industrie, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen gefragt ist. Zahlreiche M3-Gewindeöffnungen im Gehäuse des PCs ermöglichen außerdem die Montage an nahezu beliebigen Orten.



Leise durch effizientes Heatpipe-Kühlsystem

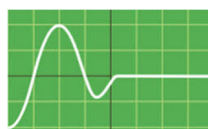
Ein aktives Doppellüfter-Heatpipe-Kühlsystem gewährleistet größtmögliche Laufruhe und Systemstabilität.



Erweiterter Temperaturbereich und für Dauerbetrieb geeignet

Das Shuttle XPC slim Barebone DH610V2 ist offiziell für den 24h-Dauerbetrieb (24/7) freigegeben. Dank seiner niedrigen Verlustleistung und des fortschrittlichen Kühlsystems ist dieser PC besonders zuverlässig. Das eignet ihn ideal für Digital Signage und POI/POS-Anwendungen - auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 50 °C (nicht kond).

Achtung: Für hohe Umgebungstemperaturen ab 40 °C werden SSD-Laufwerke empfohlen.



Einschalten nach Stromausfall

Die "Power-On after Power Fail"-Funktion im BIOS-Setup definiert, wie der PC nach einem Stromausfall reagiert: (1) unbedingt einschalten, (2) Status vor dem Stromausfall wiederherstellen (3) ausgeschaltet lassen (4) Einschalten über Netzwerk oder (5) Einschalten über Echtzeituhr (RTC). Prinzipbedingt kann diese Funktion jedoch bei sehr kurzen Stromausfällen versagen, so dass das DH610V2 zusätzlich über eine reine Hardwarelösung verfügt. Entfernt man Jumper JP2, dann startet der PC unbedingt, sobald die Stromversorgung hergestellt wird.



Unterstützt Sockel LGA1700 Intel® Core™ Prozessoren

"Alder Lake-S" und „Raptor Lake-S (Refresh)" sind die Codenamen von Intels 12./13./14. Generation der Intel® Core™ Prozessoren mit Sockel LGA1700, die zusammen mit der 600/700er-Chipsatzserie vorgestellt wurden. Intel Prozessoren der 12000/13000/14000er Serie bieten ein Hybrid-Design mit einer bestimmten Anzahl von P-Kernen (hohe Performance) und E-Kernen (hohe Effizienz). Ob für Gamer, Kreative, Streamer oder alltägliche Benutzer - jetzt steht mehr Leistung dort zur Verfügung wo sie gebraucht wird.



Externer Power-Button per Remoteleitung

Für den Fall, dass das Gerät durch räumliche Gegebenheiten (z. B. einen Festeinbau) nicht durch den frontseitig angebrachten Power-Button eingeschaltet werden kann, ist es per separater Remoteleitung startbar. Hierzu verbindet man einen Taster über die entsprechenden Pins im Backpanel des PCs. (Rastermaß: 2.54 mm). Außerdem stellt dieser Anschluss eine Clear CMOS Funktion bereit und liefert eine +5V DC Spannung für externe Geräte.

+5V voltage (2) (4) Power Button
Clear CMOS (1) (3) Ground



Unterstützt drei UHD-Displays

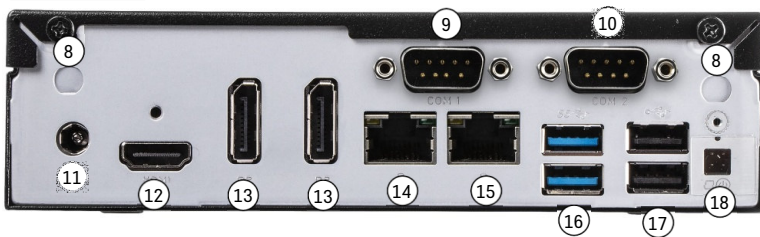
Das DH610V2 bietet drei digitale Video-Ausgänge: ein HDMI 2.0b und zwei DisplayPorts (DP 1.4), die jeweils ein 4K-Display mit 3840 x 2160 Ultra HD Auflösung (2160p) und 60Hz Bildwiederholfrequenz unterstützen. Darüber hinaus ist ein optionaler D-Sub/VGA-Ausgang möglich. Max. drei Displays gleichzeitig werden unterstützt.

Vorder- und Rückansicht

Vorderseite



Rückseite



Seitenansicht



1. Mikrofon-Eingang
2. Kopfhörer-Ausgang
3. Betriebsanzeige-LED
4. Festplatten/SSD-LED
5. Ein-/Ausschalt-Button
6. 2x USB 3.2 Gen 1 Port (1x Typ-C)
7. 2x USB 2.0
8. 2x WLAN Perforation
9. COM 1 unterstützt RS232/RS422/RS485
10. COM 2 unterstützt RS232 (oder optionaler VGA-Port für ein analoges Display)
11. DC-Anschluss für das externe Netzteil
12. 1x HDMI 2.0b Port
13. 2x DisplayPort 1.4
14. RJ45 2.5G LAN Port
15. RJ45 Gigabit LAN Port
16. 2x USB 3.2 Gen 1 Port
17. 2x USB 2.0
18. Anschluss für externen Ein-/Aus-Button, Clear CMOS und 5 V DC (4 Pins mit 2,54 mm Rastermaß)

19. Löcher mit M3-Gewinde
20. 2x Öffnung für das Kensington-Lock



21. VESA-Halterung (zwei Teile)

BENÖTIGTE KOMPONENTEN

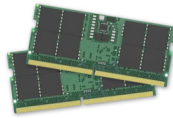
Es werden nur wenige Komponenten benötigt, um einen lauffähigen Mini-PC zu erhalten:

Shuttle XPC slim Barebone DH610V2



LGA1700 Prozessor

Intel Core Gen 12/13/14 "Alder Lake-S" oder "Raptor Lake-S [Refresh]" Core i9 / i7 / i5 / i3, Pentium Gold oder Celeron TDP max. 65 W



Speichermodule

Ein oder zwei Speichermodule:
DDR5-5600 SODIMM (oder höhere Taktrate)
jeweils max. 48 GB
(mit einer Gen12 CPU max. 32 GB pro Modul)



M.2 SSD

M.2-2280 SSD-Karte
mit SATA oder PCIe/NVMe Schnittstelle



2,5" Laufwerk

Festplatte oder SSD im 2,5"-Format
(max. Bauhöhe: 12,5 mm)



Betriebssystem

Windows 10/11 oder Linux (nur 64-Bit)

OPTIONALES ZUBEHÖR VON SHUTTLE



VGA-Port-Adapter PVG01

Der Einbau von PVG01 ersetzt eine serielle Schnittstelle (COM-Port) im Backpanel.



WLAN-Kit

WLN-M1 (802.11ax / Wifi 6)
WLN-M12 (802.11ax / Wifi 6E)
Die M.2-2230-Karte unterstützt WLAN und Bluetooth
Enthält 2 Antennen



Standfuß PS02

für den vertikalen Betrieb



Hutschienen-Kit DIR01

ermöglicht die Montage auf einer Standard 35-mm-Hutschiene



LTE Adapter Kit WWN03

ermöglicht die Installation einer M.2-LTE-Karte und einer nano SIM Karte (dabei wird der 2,5"-Schacht belegt)



Rackmount-Kit PRM01

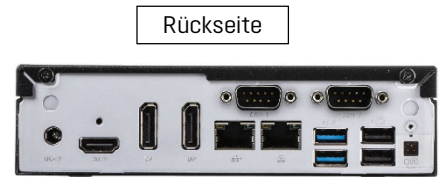
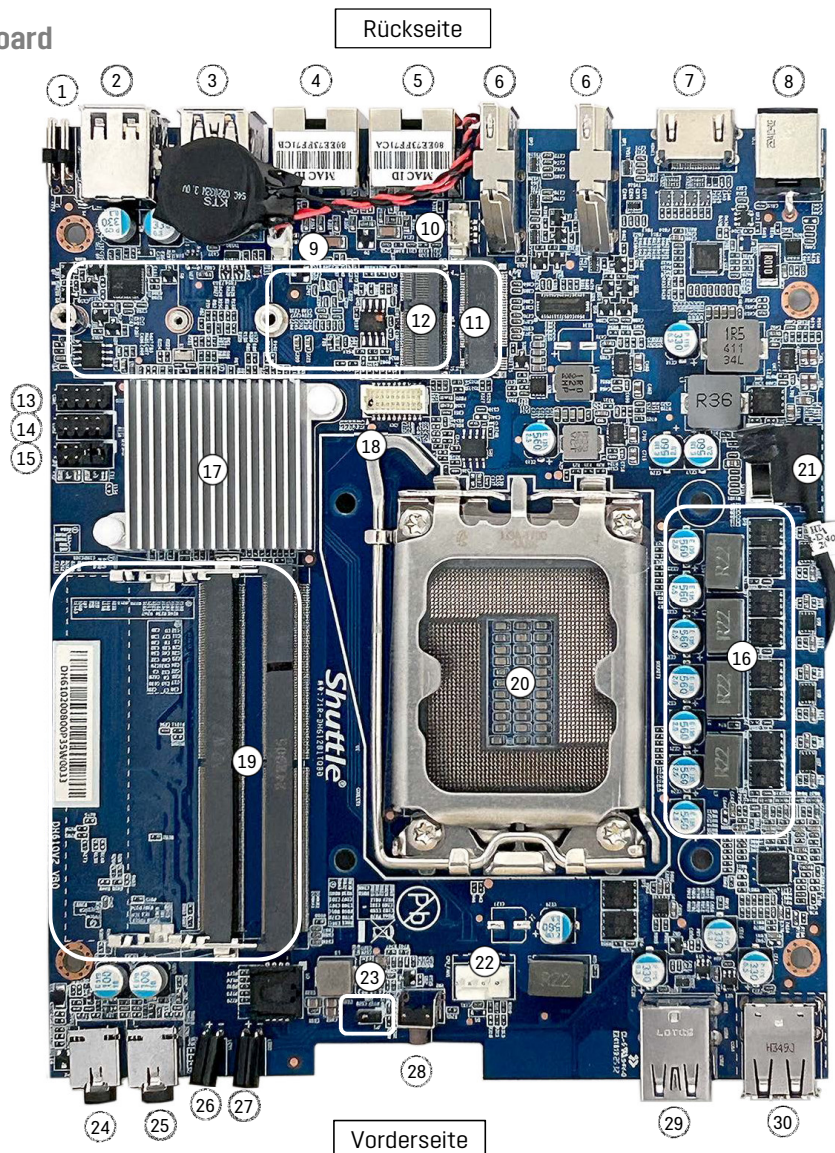
2HE-Blende für Einbau von zwei 1,3L-Shuttle-XPCs in einen 19" Schrank



Kabel CXP01

Anschlusskabel für einen externen Power-Button (ohne Button)

Mainboard



- | | |
|---|--|
| 1. 4-Pin-Anschluss für externen Ein-/Aus-Button, Clear CMOS und 5 V DC-Spannung (2,54 mm Rastermaß) | 16. CPU Spannungsregler |
| 2. 2x USB 2.0 Port | 17. Intel H610 Chipsatz mit Kühlkörper |
| 3. 2x USB 3.2 Gen 1 Port | 18. Onboard VGA connector |
| 4. RJ45 1.0G LAN Port | 19. 2x SO-DIMM-Steckplätze für DDR5-Speicher |
| 5. RJ45 2.5G LAN Port | 20. LGA1700 Prozessorsocket |
| 6. 2x DisplayPort 1.4 | 21. SATA v3.0 Anschluss |
| 7. HDMI 2.0b Port | 22. 4-Pin Anschluss für den Prozessorlüfter |
| 8. DC-Anschluss für externes Netzteil | 23. Always-Power-On Jumper (JP1) |
| 9. Anschluss für CMOS-Batterie | 24. Mikrofon-Eingang |
| 10. Onboard USB-2.0-Anschluss (4-Pin) | 25. Kopfhörer-Ausgang |
| 11. M.2-2280M Steckplatz für SSD-Karte | 26. Betriebsanzeige-LED |
| 12. M2-2230E Steckplatz für WLAN-Karte | 27. Festplatten/SSD-LED |
| 13. Onboard COM 1 Port unterstützt RS232/RS422/RS485 | 28. Ein-/Ausschalt-Button |
| 14. Onboard COM 2 port unterstützt RS232 | 29. 2x USB 3.2 Gen 1 Port (1x Typ-C) |
| 15. Jumper zur Einstellung der COM 1/2 Hilfsspannung (0/5/12 V) | 30. 2x USB 2.0 Port |

Produktvergleich: DH6xx-Serie versus DH770

MODELL	DH610S	DH610	DH610V2	DH670	DH670V2	DH770
PROZESSOR SUPPORT	Intel Core, Sockel LGA1700, TDP max. 65 W Codename "Alder Lake-S"/"Raptor Lake [Refresh]-S" – Gen 12/13/14					
CHIPSATZ	Intel H610	Intel H610	Intel H610	Intel H670	Intel H670	Intel H770
BETRIEBSSYSTEM	Windows 10/11 und Linux (64-Bit)					
MULTI-DISPLAY	max. 2 *)	max. 3	max. 3	max. 4	max. 4	max. 4
RAM-SPEICHER	max. 2x 32 GB DDR4-3200/2666 SO-DIMM (260-Pin)		max. 2x 32 GB **) DDR5-5600 SO-DIMM (262-P)	max. 2x 32 GB DDR4-3200/2666 SO-DIMM (260-Pin)		max. 2x 32 GB **) DDR5-5600 SO-DIMM (262-Pin)
2,5"-SCHACHT	1x 2,5" Laufwerksschacht, SATA-Anschluss, max. Laufwerkshöhe: 12,5 mm					
M.2-2280 SSD SLOT	unterstützt PCIe 3.0 x4 or SATA			unterstützt PCIe 4.0 x4 or SATA		
WLAN SLOT	M.2-2230E					
BUTTONS / LEDS	Power-Button, Power LED, HDD LED					
SD CARDREADER	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
GRAFIKPORTS	HDMI 2.0b DP 1.4	HDMI 2.0b 2x DP 1.4	HDMI 2.0b 2x DP 1.4	2x HDMI 2.0b 2x DP 1.4	2x HDMI 2.0b 2x DP 1.4	2x HDMI 2.0b 2x DP 1.4
USB 3.2 GEN. 2	—	—	—	4	4	4
USB 3.2 GEN. 1	4 (1x Typ-C)	4 (1x Typ-C)	4 (1x Typ-C)	4 (1x Typ-C)	4 (1x Typ-C)	4 (1x Typ-C)
USB 2.0	4	4	4	—	—	—
COM PORTS	—	2	2	2	2	2
GIGABIT NETZWERK	Single LAN Intel 219V/LM (1G)	Dual LAN Intel 225 (2.5G) Intel 219V/LM (1G)	Dual LAN Intel 225 (2.5G) Intel 219V/LM (1G)	Dual LAN Intel 210 (1G) Intel 211 (1G)	Dual LAN Intel 225 (2.5G) Intel 225 (2.5G)	Dual LAN Intel 226LM (2.5G) Intel 226LM (2.5G)
AUDIO		Mikrofon-Eingang, Line-Out (Realtek ALC662/897/888S)				... ALC888S
OPTIONALES ZUBEHÖR	WLAN-Kit (WLN-M1/M12), Standfuß (PS02), Rackmount-Kit (PRM01), VGA-Port (PVG01) Power Button Kabel (CXP01), Hutschienen-Kit (DIR01), LTE-Kit (WWN03)					
VESA-HALTER	optional PV04	mitgeliefert	mitgeliefert	mitgeliefert	mitgeliefert	mitgeliefert
NETZTEIL	120 W / 19 V					
DC-IN 12V SUPPORT	—	Ja	Ja	—	—	—

Produktbilder



*) DH610S unterstützt drei Displays, falls ein VGA-Port eingebaut wird (Zubehör PVG01)

**) DH610V2 und DH770 unterstützen max. 2x 48 GB DDR5 RAM mit einem Gen13/14 "Raptor Lake" Prozessor

SHUTTLE XPC SLIM BAREBONE DH610V2_Bundle_8GB — SPEZIFIKATION

GEHÄUSE	Slim PC mit schwarzem Metallgehäuse Abmessungen: 19 x 16,5 x 4,3 cm (LBH) = 1,35 Liter Gewicht: 1,3 kg netto und 2,1 kg brutto Zwei Öffnungen für Kensington Lock und zahlreiche M3-Gewindeöffnungen an beiden Gehäuseseiten.
NETZTEIL	Externes 120 W Netzteil (lüfterlos) Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz Ausgang: 19 V DC, 6,32 A, max. 120 W DC-Stecker: 5,5/2,5 mm (Außen/Innen-Durchmesser) Hinweis: Der DC-Eingang des Computers unterstützt eine externe Spannungsversorgung mit 19V±5% oder 12V±5% AC-Kabel: 3-polig, ca. 1,7 m lang, mit C5/C6 Kleeblatt-Steckverbindung zum Netzteil und CEE-7/7 Stecker mit Schutzkontakt (Typ E+F) für den Anschluss an die Steckdose
BETRIEBSSYSTEM	Dieses System wird ohne Betriebssystem ausgeliefert. Es ist kompatibel mit Windows 10/11 und Linux (64 Bit).
PROZESSOR-UNTERSTÜTZUNG	Prozessor Sockel LGA1700 Unterstützt Intel Core i9 / i7 / i5 / i3, Pentium Gold und Celeron Prozessoren Unterstützt folgende Generationen Intel Core Prozessoren: - Gen 12 "Alder Lake-S" - Gen 13 "Raptor Lake-S" - Gen 14 "Raptor Lake-S Refresh" in "Intel 7" Prozesstechnologie (ehemals: Intel 10 nm Enhanced SuperFin) Unterstützt nur Prozessoren mit integrierter Grafikfunktion [5] Maximal unterstützte Prozessor-Verlustleistung (TDP) = 65 W. Unterstützt nicht die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie. Der Prozessor integriert die Controller für PCI-Express und Speicher und die Grafikfunktion auf dem gleichen Halbleiter-Chip
PROZESSOR-KÜHLUNG	Heatpipe-Prozessor-Kühlung mit zwei 70-mm-Lüftern auf der Gehäuseoberseite
MAINBOARD / CHIPSATZ	Mainboard im Shuttle-Format - spezielles Design für XPC Barebone DH610V2 Chipsatz/Southbridge: Intel® H610 Passive Chipsatz-Kühlung mit Kühlkörper Die Northbridge ist im Prozessor integriert. Mit Feststoffelektrolytkondensatoren (Solid Capacitors) - diese Kondensatoren sind hitzebeständiger und langlebiger.
BIOS	AMI BIOS, SPI-Interface, 16 MB Flash-EEPROM-Baustein Unterstützt Hardware-Überwachung und Watchdog-Funktion Unterstützt Firmware-TPM (fTPM) v2.0 [9] Unterstützt Booten vom externem Flashspeicher über USB Unterstützt das Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Unterstützt Neustart nach Stromausfall (Power-On-after-Power-Fail) [7]
RAM SPEICHER	8 GB DDR5 RAM SO-DIMM-Modul mitgeliefert (das Speichermodul befindet sich in der versiegelten Zubehör-Box) Der PC verfügt über zwei SO-DIMM-Steckplätze mit 262 Pins Unterstützt DDR5-5600 (PC5-44800) SDRAM mit 1,1 V Unterstützt Dual-Channel-Modus Unterstützt maximal 48 GB pro Steckplatz Gesamtkapazität maximal 96 GB Hinweis: In Kombination mit einem Intel Core Gen 12 "Alder Lake" Prozessor werden RAM-Module bis jeweils max. 32 GB unterstützt. Unterstützt unbuffered DIMM-Module (kein ECC oder registered)
INTEGRIERTE GRAFIKFUNKTION	Die Eigenschaften der integrierten Intel UHD Grafikfunktion hängen vom verwendeten Prozessortyp ab. [5] Der PC bietet drei Video-Ausgänge, die 1080p/60 und 2160p/60 unterstützen: - 1x HDMI v2.0b - 2x DisplayPort v1.4 Unterstützt 4K-Displays mit 3840 x 2160 Ultra HD Auflösung DisplayPort und HDMI unterstützen Multikanal Digital Audio über das gleiche Kabel. Optional analoger D-Sub/VGA-Videoausgang [4] Unterstützt drei unabhängige Displays über die integrierte Grafikfunktion

LAUFWERKSSCHACHT	1x 6,35 cm / 2,5" Laufwerksschacht für eine Festplatte oder ein SSD-Laufwerk mit SATA-Anschluss Laufwerkshöhe 12,5 mm (max.)
SATA-ANSCHLUSS	1x Serial-ATA III, 6 Gb/s (600 MB/s) Datentransferrate Mit Serial-ATA Stromanschluss (onboard)
M.2-2280M SSD-STECKPLATZ	Der M.2 2280M Steckplatz bietet folgende Schnittstellen: - PCI-Express Gen. 3.0 X4 unterstützt NVMe - SATA v3.0 (max. 6 Gbit/s) Unterstützt M.2-SSD-Karten mit 22 mm Breite und 80 mm Länge (Typ 2280). Unterstützt M.2-SSDs mit SATA- oder PCI-Express-Schnittstelle.
M.2-2230E- STECKPLATZ FÜR WLAN-KARTEN	Schnittstellen: PCI-Express Gen. 2.0 X1 und USB 2.0 Verwendete M.2-2230-Steckkarten müssen 22 mm breit und 30 mm lang sein (Typ 2230) Unterstützt WLAN-Erweiterungskarten (Optionales Shuttle-Zubehör: WLN-M1, WLN-M12)
SOUNDFUNKTION	Audio Realtek® ALC 888S High-Definition Audio Zwei analoge 3,5 mm Audio-Anschlüsse auf der Vorderseite: 1) 2-Kanal Line-out (Kopfhörer) 2) Mikrofon-Eingang Digitale Multikanal-Audio-Ausgabe über HDMI und DisplayPort
DUAL NETZWERK- CONTROLLER	Zwei RJ45 Netzwerkanschlüsse mit jeweils zwei Status-LEDs Verwendete Netzwerkchips: 1) Intel i226 unterstützt 100 / 1.000 / 2.500 MBit/s Datentransferrate 2) Intel 219V/LM unterstützt 10 / 100 / 1.000 MBit/s Datentransferrate PCIe-Schnittstelle Unterstützt WAKE ON LAN (WOL) Unterstützt das Booten vom Netzwerk via Preboot eXecution Environment (PXE)
ANSCHLÜSSE VORDERSEITE	Anschlüsse Vorderseite Mikrofon-Eingang Audio Line-out (Kopfhörer) 1x USB 3.2 Gen 1 Typ A (Blau) 1x USB 3.2 Gen 1 Typ C 2x USB 2.0 Typ A (Schwarz) Ein/Aus-Button Betriebsanzeige-LED (Blau) Festplatten-LED (Gelb)
ANSCHLÜSSE RÜCKSEITE	1x HDMI 2.0b Anschluss [1] 2x DisplayPort 1.4 Anschluss (DP) [2] Optional: 1x D-Sub VGA Anschluss (Zubehör PVG01 [4]) 2x USB 3.2 Gen 1 Typ A (Blau) 2x USB 2.0 Typ A (Schwarz) 2x RJ45 LAN Port (1G + 2.5G) 2x RS232 serieller Port, 9-pol. D-Sub (5/12V, 1x RS422/RS485) [3] 1x DC-Eingang für externes Netzteil (unterstützt 19V±5%) 1x 4-Pin-Anschluss (2,54 mm Rastermaß) unterstützt: - externen Einschalt-Taster - Clear CMOS Funktion - 5V DC Spannung für externe Komponenten 2x Perforation für optionale Wireless-LAN-Antennen 2x Öffnung für Kensington Lock
WEITERE ONBOARD- ANSCHLÜSSE	1x Jumper für Power-On-after-Power-Fail (Hardware-Lösung) [7] 1x analoger VGA Grafikausgang CN6 (2x10 Pins, 1 mm Pitch) [4] 2x serielle Schnittstelle (COM) belegt für Backpanel-Anschlüsse 1x USB 2.0 (4 Pins) für optionales Zubehör WWN03 (LTE-Kit) 1x Lüfteranschluss (4 Pins) belegt durch das Kühlsystem 1x Anschluss für CMOS-Batterie (belegt)

LIEFERUMFANG	Mehrsprachige Installationsanleitung (DE, EN, FR, ES, JP, KR, SC, TC) VESA-Halterung für 75/100mm-Standard (zwei Metallwinkel) Vier Schrauben M3 x 5 mm (verbindet VESA-Halter mit PC) Vier Schrauben M4 x 10 mm (verbindet VESA-Halter mit externer Befestigung) Vier Schrauben M3 x 4 mm (zur Montage eines 2,5"-Laufwerks) Zwei Schrauben M3 x 5 mm (silberfarben, zum Befestigen von zwei M.2-Karten) Treiber-DVD (Windows 64 Bit) Serial-ATA-Kabel für 2,5"-Laufwerk mit Stromanschluss Externes 120W-Netzteil mit Netzanschlusskabel Schutzkappe für den CPU-Sockel (nicht verwenden, falls Heatpipe oder Kühler installiert sind) Wärmeleitpaste
OPTIONALES ZUBEHÖR	PVG01: Optionaler D-Sub VGA Video-Ausgang [4] WLN-M1/M12: WLAN-Modul im M.2-2230-Format mit zwei externen Antennen unterstützt WLAN und Bluetooth WWN03: LTE-Adapter-Kit mit Antennen, jedoch ohne LTE-Karte [8] PS02: Standfüße für den vertikalen Betrieb CXP01: Adapterkabel für einen externen Power-Button PRM01: 2HE-Rackblende für zwei Shuttle XPC slim PCs DIR01: Hutschienen-Montage-Kit
UMGEBUNGS-PARAMETER	Zulässiger Betriebstemperaturbereich: 0-50 °C [6] Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend: 10-90 %
ZERTIFIKATE / KONFORMITÄT	EMI: FCC, CE, BSMI, RCM, VCCI Sicherheit: CB, BSMI, ETL Weitere: RoHS, Energy Star, ErP
KONFORMITÄT	Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) (2) Richtlinie 2014/35/EU über die Sicherheit von elektrischen Betriebsmitteln (LVD) (3) Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP)

[1] **HDMI-Ausgang** unterstützt DVI mit optionalem Adapter

[2] DisplayPort in HDMI/DVI konvertieren

Der DisplayPort Ausgang kann mit einem günstigen, passiven Adapterkabel in HDMI oder DVI konvertiert werden. Zum Beispiel:

DELOCK 82590: 1 m, DisplayPort (männl., 20P) zu HDMI-A (männl., 19P)

DELOCK 82435: 5 m, DisplayPort (männl., 20P) zu DVI-D (männl., 24P)

Die integrierte Grafikfunktion erkennt die Eigenschaft des angeschlossenen Displays und gibt das passende elektrische Signal aus - entweder DisplayPort (ohne Adapter) oder HDMI/DVI (mit Adapter).

Umgekehrt kann ein Bildschirm mit DisplayPort nicht über einen einfachen, passiven Adapter an den HDMI-Ausgang angeschlossen werden.

[3] Serielle Schnittstellen

Dieser PC verfügt über zwei serielle RS232 Schnittstellen mit 9-poligen D-Sub-Anschlüssen auf der Rückseite. Der linke COM-Port (COM1) kann im BIOS-Setup auch auf RS422- und RS485-Modus umgeschaltet werden.

Pin 9 der D-Sub COM-Port-Anschlüsse ist ein multifunktionaler Anschluss. Mit dem Mainboard-Jumper JP1 lässt sich konfigurieren, ob Pin 9 als "Ring Indicator" (RI) geschaltet ist oder eine externe Spannungsversorgung von 5V bzw. 12V bietet. Jeder COM-Port ist einzeln konfigurierbar. Der maximale Strom beträgt 500 mA pro Anschluss.

[4] Optionaler D-Sub/VGA-Ausgang

Das Mainboard verfügt über einen analogen Grafikausgang CN6 auf dem Mainboard. Dieser kann über einen optionalen Adapter (PVG01) als 15-poliger D-Sub-Anschluss nach außen geführt werden. Hierbei wird eine serielle Schnittstelle (COM-Port) im Backpanel ersetzt. Die integrierte Grafik unterstützt maximal vier Displays gleichzeitig.

[5] **Nicht kompatibel sind Intel Prozessoren ohne integrierte Grafikfunktion** erkennbar an dem Buchstaben "F" in der Prozessorbezeichnung, z.B. Core i7-12700F.

[6] Betriebstemperatur

Für hohe Umgebungstemperaturen ab 40 °C werden SSD-Laufwerke (bis zu 70 °C) und SO-DIMM-Speicher mit erweitertem Temperaturbereich (bis zu 95 °C) empfohlen.

[7] Power-On-after-Power-Fail

Im BIOS-Setup unter "Power Management Configuration" befindet sich die Funktion "Power-On-after-Power-Fail", womit definiert wird wie der PC nach einem Stromausfall reagiert: (1) unbedingt einschalten, (2) Status vor dem Stromausfall wiederherstellen oder (3) ausgeschaltet lassen. Prinzipbedingt kann diese Funktion jedoch bei sehr kurzen Stromausfällen versagen, so dass das DH610V2 zusätzlich über eine reine Hardwarelösung verfügt. Entfernt man Jumper JP2 (auf dem Mainboard hinter dem Einschalt-Button), dann startet der PC unbedingt, sobald die Stromversorgung hergestellt wird.

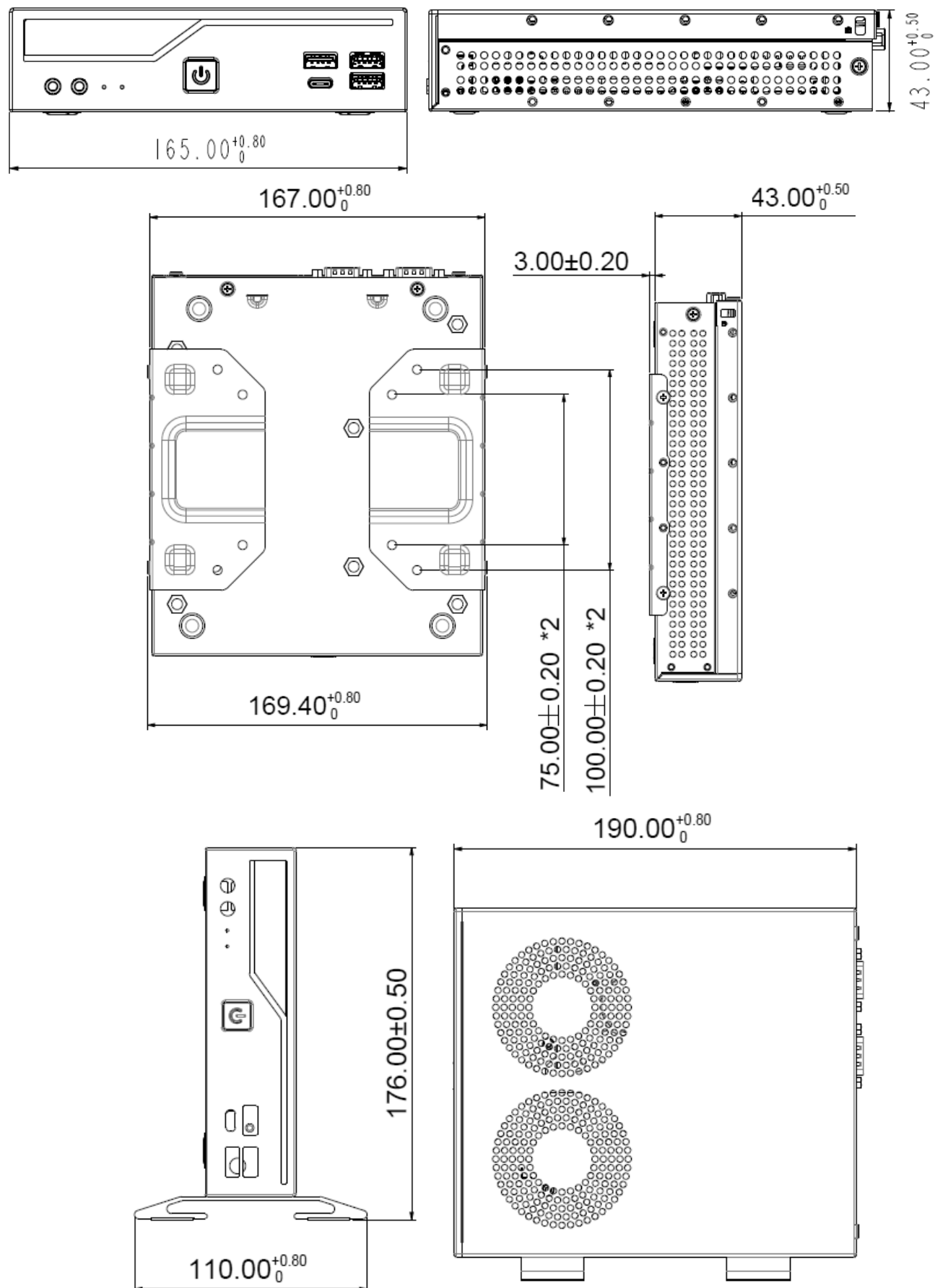
[8] Optionales Zubehör WWN03 (LTE-Kit)

Mit Hilfe des Shuttle XPC accessory WWN03 Zubehör-Kits können Sie diesen PC mit einer LTE/4G-Funktion für mobiles Netzwerk ausstatten. Hierbei wird der 2,5"-Schacht für den Einbau der LTE-Karte belegt, so dass als Massenspeicher eine SSD im M.2-Format notwendig ist. Ein LTE-Modul im M.2-3042-Format und eine Nano-SIM-Karte sind weiterhin erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten.

[9] TPM-Funktion

Dieses Produkt verfügt bereits über ein Firmware-TPM (fTPM) v2.0. Es ist außerdem für einen Hardware-TPM-Chip vorbereitet, so dass es auf Sonderbestellung im Werk bestückt werden kann.

SHUTTLE XPC SLIM BAREBONE DH610V2 – Technische Zeichnung



12. GENERATION DER INTEL CORE DESKTOP PROZESSOR-FAMILIE

Sockel LGA1700 10 nm "Alder Lake S" Prozessorübersicht (Datum: Januar 2022)

Prozessoren mit TDP > 65 W und Prozessoren ohne Grafikfunktion ("F"-Kennung) werden **nicht unterstützt (rot hinterlegt)**

PROZESSOR	MODELL	P-CORES/ THREADS	P-CORES TAKT/Turbo	E-CORES	E-CORES TAKT/Turbo	SMART CACHE	BASE TDP	SPEICHER SUPPORT	GRAFIKFUNKTION (MAX. TAKT)
Core™ i9	12900K	8 / 16	3,2 – 5,1 GHz	8	2,4 – 3,9 GHz	30 MB	125 W	DDR5-5600	UHD 770 (1.55 GHz)
	12900KF	8 / 16	3,2 – 5,1 GHz	8	2,4 – 3,9 GHz	30 MB	125 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	12900	8 / 16	2,4 – 5,0 GHz	8	1,8 – 3,8 GHz	30 MB	65 W	DDR5-5600	UHD 770 (1.55 GHz)
	12900F	8 / 16	2,4 – 5,0 GHz	8	1,8 – 3,8 GHz	30 MB	65 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	12900T	8 / 16	1,4 – 4,8 GHz	8	1,0 – 3,6 GHz	30 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 770 (1.55 GHz)
Core™ i7	12700K	8 / 16	3,6 – 4,9 GHz	4	2,7 – 3,8 GHz	25 MB	125 W	DDR5-5600	UHD 770 (1.50 GHz)
	12700KF	8 / 16	3,6 – 4,9 GHz	4	2,7 – 3,8 GHz	25 MB	125 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	12700	8 / 16	2,1 – 4,9 GHz	4	1,6 – 3,6 GHz	25 MB	65 W	DDR5-5600	UHD 770 (1.50 GHz)
	12700F	8 / 16	2,1 – 4,9 GHz	4	1,6 – 3,6 GHz	25 MB	65 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	12700T	8 / 16	1,4 – 4,6 GHz	4	1,0 – 3,4 GHz	25 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 770 (1.50 GHz)
Core™ i5	12600K	6 / 12	3,7 – 4,9 GHz	4	2,8 – 3,6 GHz	20 MB	125 W	DDR5-5600	UHD 770 (1.45 GHz)
	12600KF	6 / 12	3,7 – 4,9 GHz	4	2,8 – 3,6 GHz	20 MB	125 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	12600	6 / 12	3,3 – 4,8 GHz	–	–	18 MB	65 W	DDR5-5600	UHD 770 (1.45 GHz)
	12600T	6 / 12	2,1 – 4,6 GHz	–	–	18 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 770 (1.45 GHz)
	12500	6 / 12	3,0 – 4,6 GHz	–	–	18 MB	65 W	DDR5-5600	UHD 770 (1.45 GHz)
	12500T	6 / 12	2,0 – 4,4 GHz	–	–	18 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 770 (1.45 GHz)
	12400	6 / 12	2,5 – 4,4 GHz	–	–	18 MB	65 W	DDR5-5600	UHD 730 (1.45 GHz)
	12400F	6 / 12	2,5 – 4,4 GHz	–	–	18 MB	65 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	12400T	6 / 12	1,8 – 4,2 GHz	–	–	18 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 730 (1.45 GHz)
Core™ i3	12300	4 / 8	3,5 – 4,4 GHz	–	–	12 MB	60 W	DDR5-5600	UHD 730 (1.45 GHz)
	12300T	4 / 8	2,3 – 4,2 GHz	–	–	12 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 730 (1.45 GHz)
	12100	4 / 8	3,3 – 4,3 GHz	–	–	12 MB	60 W	DDR5-5600	UHD 730 (1.45 GHz)
	12100F	4 / 8	3,3 – 4,3 GHz	–	–	12 MB	58 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	12100T	4 / 8	2,2 – 4,1 GHz	–	–	12 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 730 (1.40 GHz)
Pentium® Gold	G7400	2 / 4	3,7 GHz	–	–	6 MB	46 W	DDR5-5600	UHD 710 (1.35 GHz)
	G7400T	2 / 4	3,1 GHz	–	–	6 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 710 (1.35 GHz)
Celeron®	G6900	2 / 2	3,4 GHz	–	–	4 MB	46 W	DDR5-5600	UHD 710 (1.30 GHz)
	G6900T	2 / 2	2,8 GHz	–	–	4 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 710 (1.30 GHz)

K = unlocked: einstellbarer Takt-Multiplikator, **T** = stromsparend, **F** = ohne integrierte Grafikfunktion, **TDP** = Thermal Design Power (max. Verlustleistung).

Hinweise: Das Shuttle XPC slim Barebone DH610V2 unterstützt nicht die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie.

P-Cores: Performance-Cores (leistungsstarke Prozessorkerne), E-Cores: Efficient-Cores (effiziente Prozessorkerne)

Core Clock: es werden Basis- und Turbo-Frequenzen genannt (die Turbo Boost 3.0-Frequenz wird hier nicht genannt)

Base TDP: maximale Prozessor-Verlustleistung, der bei der Basis-Frequenz nicht überschritten wird (Max. Turbo Power wird hier nicht genannt)

Detaillierte Informationen über kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste unter global.shuttle.com.

13. GENERATION DER INTEL CORE DESKTOP PROZESSOR-FAMILIE

Sockel LGA1700 10 nm Intel 7 / 10 nm, "Raptor Lake S" Prozessorübersicht (Datum: Januar 2023)

Prozessoren mit **TDP>65 W** und **Prozessoren ohne Grafikfunktion ("F"-Kennung)** werden **nicht unterstützt (rot hinterlegt)**

PROZESSOR	MODELL	P-CORES/ THREADS	P-CORES TAKT/Turbo	E-CORES	E-CORES TAKT/Turbo	SMART CACHE	BASE TDP	SPEICHER SUPPORT	GRAFIKFUNKTION (MAX. TAKT)
Core™ i9	13900KS	8 / 16	3,2 – 6,0 GHz	16	2,4 – 4,3 GHz	36 MB	150 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,65 GHz)
	13900K	8 / 16	3,0 – 5,8 GHz	16	2,0 – 4,3 GHz	36 MB	125 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,65 GHz)
	13900KF	8 / 16	3,0 – 5,8 GHz	16	2,0 – 4,3 GHz	36 MB	125 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	13900	8 / 16	2,0 – 5,2 GHz	16	1,5 – 4,2 GHz	36 MB	65 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,65 GHz)
	13900F	8 / 16	2,0 – 5,2 GHz	16	1,5 – 4,2 GHz	36 MB	65 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	13900T	8 / 16	1,1 – 5,1 GHz	16	0,8 – 3,9 GHz	36 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,65 GHz)
Core™ i7	13700K	8 / 16	3,4 – 5,4 GHz	8	2,5 – 4,2 GHz	30 MB	125 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,60 GHz)
	13700KF	8 / 16	3,4 – 5,4 GHz	8	2,5 – 4,2 GHz	30 MB	125 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	13700	8 / 16	2,1 – 5,1 GHz	8	1,5 – 4,1 GHz	30 MB	65 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,60 GHz)
	13700F	8 / 16	2,1 – 5,1 GHz	8	1,5 – 4,1 GHz	30 MB	65 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	13700T	8 / 16	1,4 – 4,8 GHz	8	1,0 – 3,6 GHz	30 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,60 GHz)
Core™ i5	13600K	6 / 12	3,5 – 5,1 GHz	8	2,6 – 3,9 GHz	20 MB	125 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,50 GHz)
	13600KF	6 / 12	3,5 – 5,1 GHz	8	2,6 – 3,9 GHz	20 MB	125 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	13600	6 / 12	2,7 – 5,0 GHz	8	2,0 – 3,7 GHz	24 MB	65 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,55 GHz)
	13600T	6 / 12	1,8 – 4,8 GHz	8	1,3 – 3,4 GHz	24 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,55 GHz)
	13500	6 / 12	2,5 – 4,8 GHz	8	1,8 – 3,5 GHz	24 MB	65 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,55 GHz)
	13500T	6 / 12	1,6 – 4,6 GHz	8	1,2 – 3,2 GHz	24 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,55 GHz)
	13400	6 / 12	2,5 – 4,6 GHz	4	1,8 – 3,3 GHz	20 MB	65 W	DDR5-5600	UHD 730 (1,55 GHz)
	13400F	6 / 12	2,5 – 4,6 GHz	4	1,8 – 3,3 GHz	20 MB	65 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	13400T	6 / 12	1,3 – 4,4 GHz	4	1,0 – 3,0 GHz	20 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 730 (1,55 GHz)
Core™ i3	13100	4 / 8	3,4 – 4,5 GHz	–	–	12 MB	60 W	DDR5-5600	UHD 730 (1,50 GHz)
	13100F	4 / 8	3,4 – 4,5 GHz	–	–	12 MB	58 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	13100T	4 / 8	2,5 – 4,2 GHz	–	–	12 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 730 (1,50 GHz)

K = unlocked: einstellbarer Takt-Multiplikator, **T** = stromsparend, **F** = ohne integrierte Grafikfunktion, **TDP** = Thermal Design Power (max. Verlustleistung).

Hinweise: Das Shuttle XPC slim Barebone DH610V2 unterstützt nicht die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie.

P-Cores: Performance-Cores (leistungsstarke Prozessorkerne), E-Cores: Efficient-Cores (effiziente Prozessorkerne)

Core Clock: es werden Basis- und Turbo-Frequenzen genannt (die Turbo Boost 3.0-Frequenz wird hier nicht genannt)

Base TDP: maximale Prozessor-Verlustleistung, der bei der Basis-Frequenz nicht überschritten wird (Max. Turbo Power wird hier nicht genannt)

Detaillierte Informationen über kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste unter global.shuttle.com.

14. GENERATION DER INTEL CORE DESKTOP PROZESSOR-FAMILIE

Sockel LGA1700 10 nm Intel 7 / 10 nm, "Raptor Lake S Refresh" Prozessorübersicht (Datum: Januar 2024)

Prozessoren mit **TDP>65 W** und **Prozessoren ohne Grafikfunktion ("F"-Kennung)** werden **nicht unterstützt (rot markiert)**

Wichtiger Hinweis: für Intel Core Prozessoren der 13. Generation ("Raptor Lake-S") und der 14. Generation ("Raptor Lake-S Refresh") ist eventuell ein BIOS-Update notwendig, das mit einem kompatiblen Prozessor durchgeführt werden muß.

- Generation 13 wird seit BIOS-Version 202 unterstützt (verfügbar seit März'23) und

- Generation 14 wird seit BIOS-Version 211 unterstützt (verfügbar seit Jan'24).

Download-Website: <https://global.shuttle.com/support/download>.

PROZESSOR	MODELL	P-CORES/ THREADS	P-CORES TAKT/Turbo	E-CORES	E-CORES TAKT/Turbo	SMART CACHE	BASE TDP	SPEICHER SUPPORT	GRAFIKFUNKTION (MAX. TAKT)
Core™ i9	14900K	8 / 16	3,2 – 5,6 GHz	16	2,4 – 4,4 GHz	36 MB	125 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,65 GHz)
	14900KF	8 / 16	3,2 – 5,6 GHz	16	2,4 – 4,4 GHz	36 MB	125 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	14900	8 / 16	2,0 – 5,4 GHz	16	1,5 – 4,3 GHz	36 MB	65 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,65 GHz)
	14900F	8 / 16	2,0 – 5,4 GHz	16	1,5 – 4,3 GHz	36 MB	65 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	14900T	8 / 16	1,1 – 5,1 GHz	16	0,8 – 4,0 GHz	36 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,65 GHz)
Core™ i7	14700K	8 / 16	3,4 – 5,6 GHz	8	2,5 – 4,3 GHz	33 MB	125 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,60 GHz)
	14700KF	8 / 16	3,4 – 5,6 GHz	8	2,5 – 4,3 GHz	33 MB	125 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	14700	8 / 16	2,1 – 5,3 GHz	8	1,5 – 4,2 GHz	33 MB	65 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,60 GHz)
	14700F	8 / 16	2,1 – 5,4 GHz	8	1,5 – 4,2 GHz	33 MB	65 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	14700T	8 / 16	1,3 – 5,0 GHz	8	0,9 – 3,7 GHz	33 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,60 GHz)
Core™ i5	14600K	6 / 12	3,5 – 5,3 GHz	8	2,6 – 4,0 GHz	24 MB	125 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,50 GHz)
	14600KF	6 / 12	3,5 – 5,3 GHz	8	2,6 – 4,0 GHz	24 MB	125 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	14600	6 / 12	2,7 – 5,2 GHz	8	2,0 – 3,9 GHz	24 MB	65 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,55 GHz)
	14600T	6 / 12	1,8 – 5,1 GHz	8	1,3 – 3,6 GHz	24 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,55 GHz)
	14500	6 / 12	2,6 – 5,0 GHz	8	1,9 – 3,7 GHz	24 MB	65 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,55 GHz)
	14500T	6 / 12	1,7 – 4,8 GHz	8	1,2 – 3,4 GHz	24 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 770 (1,55 GHz)
	14400	6 / 12	2,5 – 4,7 GHz	4	1,8 – 3,5 GHz	20 MB	65 W	DDR5-5600	UHD 730 (1,55 GHz)
	14400F	6 / 12	2,5 – 4,7 GHz	4	1,8 – 3,5 GHz	20 MB	65 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	14400T	6 / 12	1,5 – 4,5 GHz	4	1,1 – 3,2 GHz	20 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 730 (1,55 GHz)
Core™ i3	14100	4 / 8	3,5 – 4,7 GHz	–	–	12 MB	60 W	DDR5-5600	UHD 730 (1,50 GHz)
	14100F	4 / 8	3,5 – 4,7 GHz	–	–	12 MB	58 W	DDR5-5600	Nicht vorhanden
	14100T	4 / 8	2,7 – 4,4 GHz	–	–	12 MB	35 W	DDR5-5600	UHD 730 (1,50 GHz)

K = unlocked: einstellbarer Takt-Multiplikator, **T** = stromsparend, **F** = ohne integrierte Grafikfunktion, **TDP** = Thermal Design Power (max. Verlustleistung).

Hinweise: Das Shuttle XPC slim Barebone DH610V2 unterstützt nicht die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie.

P-Cores: Performance-Cores (leistungsstarke Prozessorkerne), E-Cores: Efficient-Cores (effiziente Prozessorkerne)

Core Clock: es werden Basis- und Turbo-Frequenzen genannt (die Turbo Boost 3.0-Frequenz wird hier nicht genannt)

Base TDF: maximale Prozessor-Verlustleistung, der bei der Basis-Frequenz nicht überschritten wird (Max. Turbo Power wird hier nicht genannt)

Detaillierte Informationen über kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste unter global.shuttle.com.